

多様な基材にしっかり密着

高性能薄膜用 スパッタリング ターゲット材 MVF合金 / NVF合金



特長

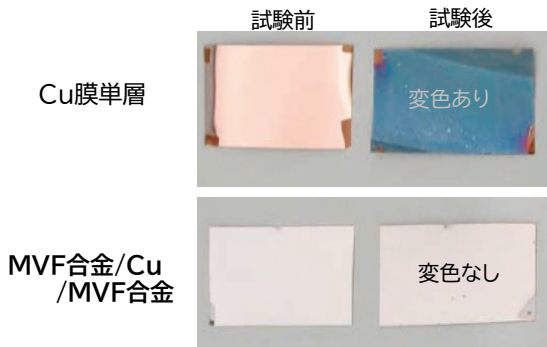
- ・樹脂、金属など多様な基材に対応
- ・研究用小ロットでもカスタマイズ
- ・高耐湿性(MVF)、はんだ接合性(NVF)

用途

- ・フィルム配線
- ・半導体実装基板

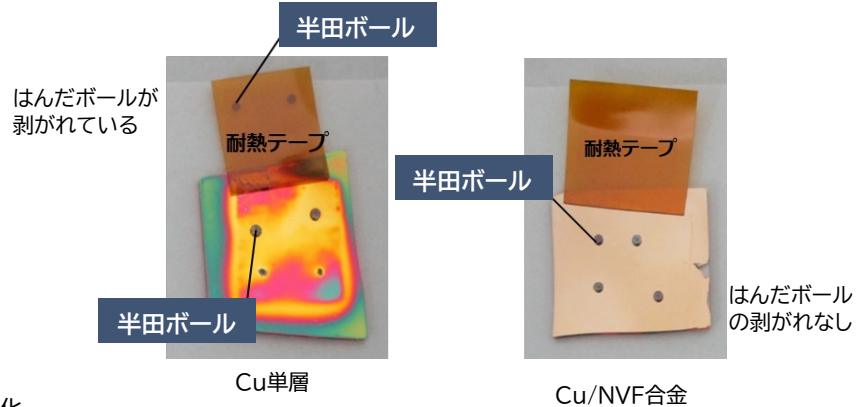
■ MVF合金高温高湿試験

(85°Cx85%RH 300hr)



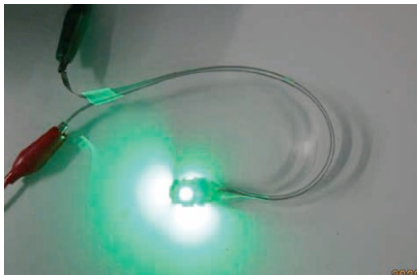
▲低抵抗なCu膜を保護し耐湿性・耐酸化性を強化

■ NVF合金はんだ接合性試験



■ 各基材との密着性評価

厚さ0.1mmのPET上にCu積層膜を形成、切断し、T5LEDに接続



材質	MVF-56	NVF-X11A	Cu
PET(エステル系)	◎	◎	○
PI(イミド系)	◎	◎	○
PTFE(フッ素系)	×	△	×
密着性簡易評価 (テフロン系シートに成膜後、一部を引き剥がし)	 剥がれる(×)	 残る(○)	 剥がれる(×)

問合せ窓口

株式会社プロテリアル

電子材事業部

東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア

